

受付 番号	プログラム 番号	連絡先氏名	所属	日本語タイトル
1	42	柄澤 泰紀	リンテック株式会社	シート状高耐熱封止材の接着性向上
2	11	米澤 徹	北海道大学 工学研究院	化学合成法による銅微粒子による低温焼結への挑戦
3	77	内海 淳	三菱重工工作機械(株)	極薄Si中間層を用いた常温によるCu/SiO <sub>2</sub> ハイブリッド接合
4	43	山田 由香	株式会社 豊田中央研究所	非晶質薄膜を介した銅とモールド樹脂の接合
5	59	西川 剛史	パナソニック株式会社	異方性高熱伝導材料における面方向熱伝導率測定手法の開発
6	60	近藤 大雄	株式会社富士通研究所	カーボンナノチューブを用いた放熱材料の熱特性と信頼性評価
7	68	小林 竜也	群馬大学大学院 理工学府	Sn-Sb-Ni系高温用鉛フリーはんだの微細組織および機械的特性
8	28	酒 金婷	千住金属工業株式会社	次世代半導体用マイクロ銀粒子ダイアタッチ材の組成及び接合プロセス
9	73	YEON Jaebong	大阪大学	酸化銅粉末の還元・焼結処理による表面微細クレバス構造における特異拡張濡れを利用した金属銅基板の接合
10	78	深井 祐佑	群馬大学大学院	熱交換機用Niろうの電気化学測定による腐食挙動調査
11	12	首藤 高德	大分県産業科学技術センター	銅ナノ粒子の焼結への超音波接合技術の応用に関する研究
12	10	長谷川 典彦	奥野製薬工業株式会社	パワーモジュール向け無電解Ni-Pめっき皮膜の開発
13	29	須藤 皓紀	千住金属工業株式会社	銅核カラムのファインピッチ3D実装への応用の可能性
14	55	斎藤 彰	株式会社村田製作所	Sn-Inはんだ実装品におけるSnウイスカ成長メカニズム
15	30	櫻井 大輔	パナソニック株式会社	チップオンウエハにおける熱揺らぎ低減による高精度実装プロセスの開発
16	71	宮崎 高彰	株式会社日立製作所	はんだ接合部におけるパワーサイクル信頼性と劣化モード
17	74	松田 朋己	大阪大学	酸化銀分解反応によるシリコン系材料の直接接合とその機構
18	35	長岡 秀明	株式会社富士通研究所	樹脂の硬化過程における粘弾性を考慮した回路基板の反り解析技術
19	8	岸本 貴臣	田中貴金属工業株式会社	活性金属ろう材/銅複合材の開発
20	21	松井 智香	三菱電機株式会社	パワーモジュールの液状封止樹脂中のポイド抑制
21	25	穴戸 信之	北九州市環境エレクトロニクス研究所	機械疲労試験によるパワーモジュール用アルミワイヤ接合部の寿命評価
22	58	和田 剛優	株式会社弘輝	スルーホール接合部のリフトオフ発生を抑制する高耐久はんだ合金の開発
23	4	松原 望	日立化成株式会社	パワーデバイスの一括ボンディングに向けた荷重均一化フィルム
24	56	李 建永	株式会社クオルテック	リフロー過程中の合金層形成及びはんだ付け性への影響
25	19	岡田 徹	富士通アドバンステクノロジー株式会社	超高速温度可変装置を用いたはんだ接合部信頼性評価に関する考察
26	51	大田 賢吾	大阪大学大学院	Agペースト配線の電気特性に及ぼすフィラー接触および混合比の影響
27	47	坂本 暁祐	早稲田大学 先進理工学研究科 ナノ理工学専攻	メッシュパターンを有するフレキシブル酸化インジウムスズ電極の開発
28	44	上林 拓海	早稲田大学 先進理工学研究科 ナノ理工学専攻	ビルドアップ樹脂を用いた熱インプリントプロセスによる高アスペクト比極微細ビア電極の作製
29	24	多谷本 真聡	大阪大学	熱硬化・熱可塑性ハイブリッド樹脂封止によるパワーモジュールの高信頼性化
30	61	袁 群	メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社	パワー補正技術を用いた定常法によるフィラー粉体の熱伝導率の評価
32	57	上野 裕輔	大阪大学大学院	ソルダ樹脂ペーストを用いたパンプ形成におけるフィラー合一挙動の均一化
33	16	古賀 俊一	大阪大学	Cuナノポーラスシートを用いた接合体の劣化挙動の解明
34	72	酒井 翼	中京大学	原子流速がエレクトロマイグレーション寿命に与える影響
35	32	岩井 俊樹	株式会社富士通研究所	層間接続ビアに導電性ペーストを用いた多層ガラス基板の開発
36	1	中子 偉夫	日立化成株式会社	焼結Cu接合材: 接合条件の改良およびその接続信頼性
37	2	清水 悠矢	三菱電機株式会社	大面積ダイボンド部の気泡の挙動の可視化によるポイド低減手法の検討
38	23	池田 徹	鹿児島大学	パワーモジュールにおける樹脂と金属の熱サイクル疲労寿命の予測
39	48	前田 世蓮	早稲田大学	フレキシブル木質系炭素材料を用いた水蒸気発電デバイス
40	50	上野 秀貴	群馬大学	バイオマイクロチップのための厚膜感光性材料を用いたポーラス構造上への微細電極集積法
41	80	山下 浩明	東京工業大学	くし状金型の積層による側面接触型梁集合体の大面積成形方法
42	65	堀川 貴正	東京理科大学	不良率を考慮する場合の生産ラインのエネルギー原単位の定式化に関する研究
43	26	中島 泰	三菱電機株式会社 コンポーネント製造技術センター	モールド樹脂封止型パワーモジュールのワイヤボンド接合部の破断モード
44	66	中村 匠	大阪大学	混合品種ライン生産における投入順序・部品搬送の改良型統合化計画
45	36	佐藤 牧子	ナミックス株式会社	ナノアンカー銅箔の開発 ~低粗化・高密着・高信頼性の実現~
46	69	三ツ井 恒平	群馬大学	Sn-5SbおよびSn-Sb-Ag三元共晶合金の高温疲労特性
47	76	辻野 次郎丸	神奈川大学、株式会社 LINK-US	回転する円形振動軌跡を有する交換可能な複合曲げ振動溶接チップを用いた27 kHz, 40 kHzの超音波複合振動溶接装置の開発
48	27	中島 悠太	芝浦工業大学大学院	非弾性ひずみエネルギー密度を用いたSn-Sb系合金/Cu接合部の疲労き裂進展速度の評価
49	40	松嶋 道也	大阪大学	微細フィラー混合による低融点金属含有導電性樹脂の熱伝導特性に及ぼす影響
50	18	坂居 貴雅	芝浦工業大学大学院	単結晶ピスマスにおける双晶変形と双晶回復挙動
51	20	石橋 淳	芝浦工業大学大学院	フィラー添加したエポキシ樹脂の疲労き裂進展解析
52	52	齊藤 拓也	日本パイリオン株式会社	薄膜基材の高平滑な吸着固定を実現する超極細繊維シート
53	31	三宅 弘人	株式会社ダイセル	ファンアウト実装に向けたフィルム材料の開発
55	22	音田 慎吾	株式会社ADEKA	パワーモジュール向け高放熱接着シートの開発
56	45	安孫子 瞳	群馬大学大学院	構造用接着剤の接着強度の劣化に及ぼす高温高湿環境の影響
57	5	孝井 健一	産業技術総合研究所	高温動作SiCパワーモジュール用低ヤング率ベースプレートのはんだ接合信頼性
58	70	山崎 浩次	三菱電機株式会社	In添加鉛フリーはんだのポイド低減プロセスの検討
59	7	原田 啓行	三菱電機株式会社	パワーモジュールにおける表面実装パッケージング技術の開発
61	53	柏木 行康	大阪産業技術研究所	低加圧銀ナノ粒子ペースト接合における荷重と塗布方法の影響
62	13	川戸 祐一	石原ケミカル株式会社	加圧接合型Cuナノペーストの焼結と機械特性
63	41	青木 豊広	日本アイ・ビー・エム株式会社	永久膜レジストマスクを用いたバンピングとフリップチップ接合の2.5Dパッケージへの適用 -樹脂材料特性がパッケージ信頼性に及ぼす影響-
64	17	佐藤 隆彦	芝浦工業大学大学院	エネルギー密度を基準とした要素削除による疲労き裂進展解析手法の検討
65	62	佐々木 伸也	(株)富士通研究所	ファンアウト型ウエハレベルパッケージにおける放熱構造
66	63	長尾 至成	大阪大学	SiCマイクロヒータチップを用いたセラミック基板の熱特性評価とパワーサイクル試験
67	3	大矢 怜史	株式会社クオルテック	無電解Ni-Cu-Pめっきを用いたNi-P/Sn-0.7Cuはんだ接合界面の高耐熱化
68	9	外蘭 洋昭	富士電機株式会社	高温動作におけるIGBT電極表面の信頼性向上
69	34	小原 さゆり	日本アイ・ビー・エム株式会社	有機基板における構成材料の面内異方性が及ぼす反り形状への影響
71	39	木村 文信	東京大学	金属表面微細構造への樹脂充填量解析による成形接合の評価
72	75	O Minho	東京工業大学	533Kにおける固相Niと液相Sn-Zn合金の反応拡散による化合物成長
73	6	金井 直之	富士電機(株)	3.3kV SiCトレンチMOSFETを搭載した配電機器向けパワーモジュール
74	79	衡 中皓	大阪大学	フェルトセパレータと複合カソードに基づくMg-空気電池の性能向上
75	49	葛西 靖明	オリンパス株式会社	ファイバー走査技術による細径・高解像度血管内視鏡の実現
76	14	工藤 勝裕	東海大学湘南キャンパス	接合後熱処理によるAgナノ粒子焼結接合層の変化
77	46	瓦井 健太	群馬大学大学院	フェノール基銅系導電性ペーストを大気キュア可能にするアミン系表面処理剤の分子構造上の特徴
78	15	井上 雅博	群馬大学	特定の有機化合物の作用により促進される銀マイクロ粒子の低温焼結現象
79	54	井上 雅博	群馬大学	繰返し変形により引き起こされる伸縮性印刷配線の導電性変化と回復現象
80	37	吉澤 正充	株式会社野田テクノ	チップ貼付用STO薄膜バイパスキャパシタの低インダクタンス接続構造
81	67	岩田 剛治	大阪大学	大規模システムにおけるシステムモデル分割に基づく階層型多目的最適化手法に関する研究